

お客様 各位

ルネサス エレクトロニクス株式会社
 第二ソリューション事業本部 汎用第二事業部
 アナログ&パワーソリューション第三部
 発行日 : 2016年1月8日
 管理番号 : CST-R2-T664 Rev.1.1

4Mb低消費電力SRAM TSOPパッケージ製品の後工程生産拠点変更に関するご案内

拝啓

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
 このたび弊社では、4Mb低消費電力SRAM TSOPパッケージの計4製品(RMLV0408EGSA-4S2, RMLV0408EGSB-4S2, RMLV0416EGSB-4S2, RMLV0414EGSB-4S2)に関し、
 市場環境変化に対応した長期安定供給を目的として、後工程(組立・選別テスト)生産拠点変更を進めさせて頂く運びとなりました。
 お手数をお掛けし、まことに恐縮ではございますが、主旨ご理解の上、変更後品の早期ご承認を賜りますよう、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 敬具

1. 変更の概要

- (1) 現在の後工程(組立・選別テスト)生産拠点である Renesas Semiconductor Beijing(但し、RMLV0408EGSA-4S2 の組立拠点は Amkor Technology Taiwan)から、組立拠点を Amkor Technology Malaysia、選別テスト拠点を Powertech Technology Inc. に移管いたします。

		RMLV0408EGSA-4S2	RMLV0408EGSB-4S2	RMLV0416EGSB-4S2 RMLV0414EGSB-4S2
組立 拠点	変更前	Amkor Technology Taiwan	Renesas Semiconductor Beijing	
	変更後	Amkor Technology Malaysia		
選別テスト 拠点	変更前	Renesas Semiconductor Beijing		
	変更後	Powertech Technology Inc.		

- (2) 変更前後で、
- (a) ウェブプロセス前工程の生産拠点は変更無く、現拠点にて安定量産を継続致します。
 - (b) SRAMの電気的特性(DC/AC)は変更ありません。
 - (c) パッケージの材質、外形寸法、ピン配置は同等です。
 - (d) 製品の信頼性、品質レベルは同等です。
 - (e) 梱包仕様の変更がございます。
- 詳細は 2 ~ 6 頁をご覧ください。

2. スケジュール (予定)

	RMLV0408EGSA-4S2	RMLV0408EGSB-4S2	RMLV0416EGSB-4S2 RMLV0414EGSB-4S2
信頼性保証 サンプル	2016年3月	2016年5月	2016年2月
変更後製品の 量産開始時期	2016年6月	2016年6月	2016年3月
変更前製品の 生産終了時期	2016年9月	2016年12月	2016年12月

3-1.変更前後比較 32pin sTSOP (I) パッケージ 製品型名 : RMLV0408EGSA-4S2

項目	変更前	変更後	備考	
受注型名	RMLV0408EGSA-4S2#AA0 (トレイ品) RMLV0408EGSA-4S2#KA0 (Tape & Reel品)	RMLV0408EGSA-4S2#AA1 (トレイ品) RMLV0408EGSA-4S2#KA1 (Tape & Reel品)		
組立拠点	Amkor Technology Taiwan (台湾)	Amkor Technology Malaysia (マレーシア)		
マーキング原産国表示	TAIWAN	MALAYSIA		
JEITA Package Code	P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	P-TSOP(1)32-8x11.8-0.50	変更前後で 実装コンパチブル	
パッケージ表面仕様 (マーキング、1ピンマーク)	<p>製品型名 電気特性 (スピードアイテム) データコード</p> <p>原産国(後工程：組立)</p>	<p>製品型名 電気特性 (スピードアイテム) データコード</p> <p>原産国(後工程：組立)</p>		
材料	リードフレーム材質	Cu	Cu	材料は同等
	リードフレームの内部形状 (インナーリード)	現行仕様	仕様変更なし	
	リードめっき材	純Sn	純Sn	材料は同等
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト	材料は同等
	ボンディングワイヤー	Au	Au	材料は同等
	封止材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	材料は同等
選別テスト拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Powertech Technology Inc. (台湾)		
トレイ品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (TSOP I package size: 8mm x 11.8mm)	JEDEC Tray ルネサスロゴ無し (TSOP I package size: 8mm x 11.8mm)	材料は同等
	収納数	234pcs/tray	234pcs/tray	
	トレイ段数(Max.)	8枚+1枚(フタ)	10枚+1枚(フタ)	
	内装箱サイズ (LxWxH)	330mm x 152mm x 75mm	351mm x 175mm x 104mm	
Tape & Reel品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	エンボステーブ	現行仕様	新仕様	
	収納数	1,000pcs/reel	1,000pcs/reel	
内装箱サイズ (LxWxH)	288mm x 273mm x 48mm	289mm x 264mm x 60mm		
出荷梱包ラベル	現行仕様	仕様変更なし	原産国と型名は変更	

3-2.変更前後比較 32pin TSOP (II) パッケージ 製品型名 : RMLV0408EGSB-4S2

項目	変更前	変更後	備考	
受注型名	RMLV0408EGSB-4S2#AA0 (トレイ品) RMLV0408EGSB-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	RMLV0408EGSB-4S2#AA1 (トレイ品) RMLV0408EGSB-4S2#HA1 (Tape & Reel品)		
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Amkor Technology Malaysia (マレーシア)		
マーキング原産国表示	CHINA	MALAYSIA		
JEITA Package Code	P-TSOP(2)32-10.16x20.95-1.27	P-TSOP(2)32-10.16x20.95-1.27	変更前後で 実装コンパチブル	
パッケージ表面仕様 (マーキング、1ピンマーク)				
材料	リードフレーム材質	Cu	Cu	材料は同等
	リードフレームの内部形状 (インナーリード)	現行仕様	新仕様 (現行の形状から変更あり)	
	リードめっき材	純Sn	純Sn	材料は同等
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト	材料は同等
	ボンディングワイヤー	Au	Au	材料は同等
	封止材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	材料は同等
選別テスト拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Powertech Technology Inc. (台湾)		
トレイ品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (TSOP II package size: 10.16mm x 20.95mm)	JEDEC Tray ルネサスロゴ無し (TSOP II package size: 10.16mm x 20.95mm)	材料は同等
	収納数	117pcs/tray	117pcs/tray	
	トレイ段数(Max.)	8枚+1枚(フタ)	10枚+1枚(フタ)	
	内装箱サイズ (LxWxH)	330mm x 152mm x 75mm	351mm x 175mm x 104mm	
Tape & Reel品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	エンボステーブ	現行仕様	新仕様	
	収納数	1,000pcs/reel	1,000pcs/reel	
	内装箱サイズ (LxWxH)	288mm x 273mm x 48mm	289mm x 264mm x 60mm	
出荷梱包ラベル	現行仕様	仕様変更なし	原産国と型名は変更	

3-3.変更前後比較 44pin TSOP (II)品 製品型名 : RMLV0416EGSB-4S2

項目	変更前	変更後	備考	
受注型名	RMLV0416EGSB-4S2#AA0 (トレイ品) RMLV0416EGSB-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	RMLV0416EGSB-4S2#AA1 (トレイ品) RMLV0416EGSB-4S2#HA1 (Tape & Reel品)		
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Amkor Technology Malaysia (マレーシア)		
マーキング原産国表示	CHINA	MALAYSIA		
JEITA Package Code	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	変更前後で 実装コンパチブル	
パッケージ表面仕様 (マーキング、1ピンマーク)	<p>原産国 (後工程:組立) ←</p> <p>製品型名 電気特性 (スピードアイテム) →</p> <p>→ デートコード</p>	<p>原産国 (後工程:組立) ←</p> <p>製品型名 電気特性 (スピードアイテム) →</p> <p>→ デートコード</p> <p>← 1ピンマーク</p>		
材料	リードフレーム材質	Cu	Cu	材料は同等
	リードフレームの内部形状 (インナーリード)	現行仕様	新仕様 (現行の形状から変更あり)	
	リードめっき材	純Sn	純Sn	材料は同等
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト	材料は同等
	ボンディングワイヤー	Au	Au	材料は同等
	封止材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	材料は同等
選別テスト拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Powertech Technology Inc. (台湾)		
トレイ品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (TSOP II package size: 10.16mm x 18.41mm)	JEDEC Tray ルネサスロゴ無し (TSOP II package size: 10.16mm x 18.41mm)	材料は同等
	収納数	135pcs/tray	135pcs/tray	
	トレイ段数(Max.)	8枚+1枚(フタ)	10枚+1枚(フタ)	
	内装箱サイズ (LxWxH)	330mm x 152mm x 75mm	351mm x 175mm x 104mm	
Tape & Reel品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	エンボステーブ	現行仕様	新仕様	
	収納数	1,000pcs/reel	1,000pcs/reel	
	内装箱サイズ (LxWxH)	288mm x 273mm x 48mm	289mm x 264mm x 60mm	
出荷梱包ラベル	現行仕様	仕様変更なし	原産国と型名は変更	

3-4.変更前後比較 44pin TSOP (II)品 製品型名 : RMLV0414EGSB-4S2 (チップ選択端子 : 1ピン仕様)

項目	変更前	変更後	備考	
受注型名	RMLV0414EGSB-4S2#AA0 (トレイ品) RMLV0414EGSB-4S2#HA0 (Tape & Reel品)	RMLV0414EGSB-4S2#AA1 (トレイ品) RMLV0414EGSB-4S2#HA1 (Tape & Reel品)		
組立拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Amkor Technology Malaysia (マレーシア)		
マーキング原産国表示	CHINA	MALAYSIA		
JEITA Package Code	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	P-TSOP(2)44-10.16x18.41-0.80	変更前後で 実装コンパチブル	
パッケージ表面仕様 (マーキング、1ピンマーク)				
材料	リードフレーム材質	Cu	Cu	材料は同等
	リードフレームの内部形状 (インナーリード)	現行仕様	新仕様 (現行の形状から変更あり)	
	リードめっき材	純Sn	純Sn	材料は同等
	ダイボンディング材	樹脂ペースト	樹脂ペースト	材料は同等
	ボンディングワイヤー	Au	Au	材料は同等
	封止材料	エポキシ樹脂	エポキシ樹脂	材料は同等
選別テスト拠点	Renesas Semiconductor Beijing (中国)	Powertech Technology Inc. (台湾)		
トレイ品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	トレイ	JEDEC Tray ルネサスロゴ有り (TSOP II package size: 10.16mm x 18.41mm)	JEDEC Tray ルネサスロゴ無し (TSOP II package size: 10.16mm x 18.41mm)	材料は同等
	収納数	135pcs/tray	135pcs/tray	
	トレイ段数(Max.)	8枚+1枚(フタ)	10枚+1枚(フタ)	
	内装箱サイズ (LxWxH)	330mm x 152mm x 75mm	351mm x 175mm x 104mm	
Tape & Reel品	梱包仕様	現行仕様	新仕様	
	エンボステーブ	現行仕様	新仕様	
	収納数	1,000pcs/reel	1,000pcs/reel	
	内装箱サイズ (LxWxH)	288mm x 273mm x 48mm	289mm x 264mm x 60mm	
出荷梱包ラベル	現行仕様	仕様変更なし	原産国と型名は変更	

3-5. 変更前後比較 梱包仕様の変更内容

(1) トレイ変更内容

- ・ トレイにおけるパッケージの着座高さが変更になります。下記の表をご参照ください。
- ・ JEDEC規定寸法（外形寸法、ポケットピッチ等）の変更はございません。

	パッケージタイプ	変更前		変更後	
		トレイ型名	パッケージ着座高さ (mm)	トレイ型名	パッケージ着座高さ (mm)
トレイ	32pin sTSOP (I)	L196-10	2.0	EA50813	1.85
	32pin TSOP (II)	L196-93	2.0	EA80817	2.0
	44pin TSOP (II)	L196-92	2.0	EA80815	2.0



トレイポケット断面図

(2) テープ&リール変更内容

- ・ エンボステープにおけるパッケージの着座高さが変更になります。下記の表をご参照ください。
- ・ エンボステープ幅、エンボステープピッチの変更はございません。
- ・ リール径の変更はございません。

	パッケージタイプ	変更前		変更後	
		エンボス型名	パッケージ着座高さ (mm)	エンボス型名	パッケージ着座高さ (mm)
エンボス キャリア テープ	32pin sTSOP (I)	MTE2412H-28P2C-A	1.3	TSOP28	1.4
	32pin TSOP (II)	MTE3216H-50P3W	1.2	TSOP32-6	1.3
	44pin TSOP (II)	MTE3216H-28P3Y	1.2	TSOP44-3	1.3

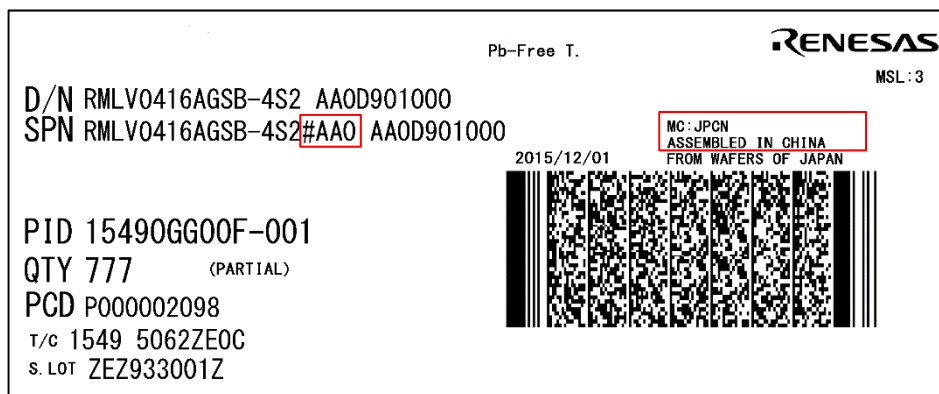


エンボステープ ポケット断面図

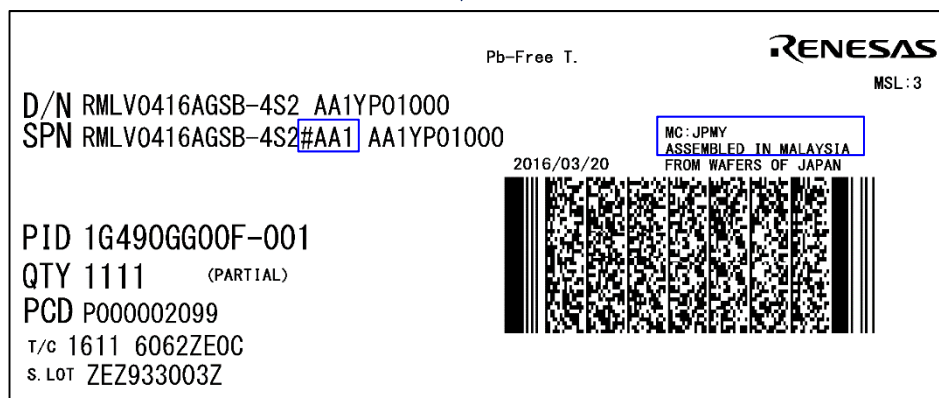
4. 変更前後製品の識別について

パッケージ現物のマーキング原産国表示において識別可能ですが、出荷梱包ラベル上での型名と組立原産国表示も変更となるため、梱包状態においても識別可能です。

変更前



変更後



5. 移管先拠点の概要

<組立拠点>

- 会社名 Amkor Technology Malaysia Sdn,Bhd. (マレーシア)
- 所在地 15km, Jalan Klang-Banting, 42507 Telok Panglima Garang, Kuala Langat, Selangor, Malaysia

<選別テスト拠点>

- 会社名 Powertech Technology Inc. (台湾)
- 所在地 No.10, Datong Rd., Hsinchu Industrial Park, Hukou, Hsinchu 30352, Taiwan

6. お問い合わせ

本内容に関するお問い合わせは、弊社販売員または弊社販売特約店にご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

以上の内容をご査収下さり、拠点変更・材料変更に関するご理解・承認を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

以上